

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2010 年 2 月 18 日(18.02.2010)

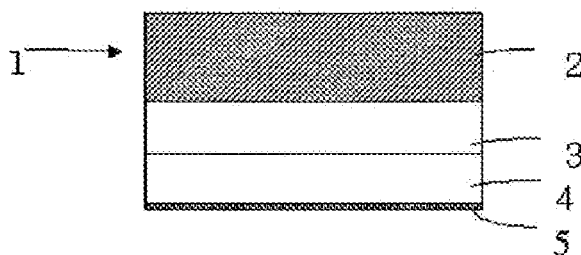
(10) 国際公開番号
WO 2010/018791 A1

- (51) 国際特許分類:
B65D 65/40 (2006.01) *B65D 77/20* (2006.01)
B32B 7/02 (2006.01) *B65D 85/86* (2006.01)
B65D 73/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2009/064006
- (22) 国際出願日: 2009 年 8 月 7 日(07.08.2009)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2008-207583 2008 年 8 月 12 日(12.08.2008) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 米澤 賢輝 (YONEZAWA Takaki) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 弁理士 八木 敏安 (YAGI Toshiyasu); 〒5320011 大阪府大阪市淀川区西中島 5 丁目 7
- 番 1 9 号 第 7 新大阪ビル 6 0 2 号 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: COVER TAPE FOR PACKAGING ELECTRONIC PART AND ELECTRONIC-PART PACKAGE

(54) 発明の名称: 電子部品包装用カバーテープおよび電子部品包装体

[図1]



(57) Abstract: A cover tape for packaging electronic parts is provided which is free from the fouling of a sealing iron caused by the outflow of a cushioning layer and has excellent adhesion to a carrier tape. The cover tape for packaging electronic parts can be heat-sealed to a carrier tape for packaging electronic parts. The cover tape comprises a base layer, a cushioning layer constituted of a resin (A), a conforming layer for heat sealing constituted of a resin (B), and a heat-sealable layer which have been superposed in this order. The Vicat softening temperature of the resin (A), Ta, as measured in accordance with ISO306 (heating rate, 50 °C/hr; load, 10 N) and the Vicat softening temperature of the resin (B), Tb, as measured in accordance with ISO306 (heating rate, 50 °C/hr; load, 10 N) satisfy relationship (1). The conforming layer for heat sealing has a thickness of 2-15 μm. Relationship 1: Ta-Tb≥3 (°C)

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2010/018791 A1



クッション層の流出によるシールコテの汚染がなく、さらにキャリアテープとの密着性に優れた電子部品包装用カバーテープを提供する。電子部品包装用キャリアテープにヒートシールしうる電子部品包装用カバーテープであって、少なくとも基材層、クッション層、樹脂Bからなるヒートシール追従層及びヒートシール層がこの順に積層され、上記樹脂AのISO 306により測定したビカット軟化点温度 T_a （昇温速度：50℃/時、荷重：10N）と、上記樹脂BのISO 306により測定したビカット軟化点温度 T_b （昇温速度：50℃/時、荷重：10N）とが、下記関係式1を満たし、上記ヒートシール追従層の厚みが2 μm 以上15 μm 以下である電子部品包装用カバーテープ。関係式1： $T_a - T_b \geq 3$ （℃）